

证券代码：600460

证券简称：士兰微

编号：临 2026-032

杭州士兰微电子股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），并经上海证券交易所同意，本公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 248,000,000 股，每股发行价格为每股人民币 20.00 元，共计募集资金 496,000.00 万元，坐扣承销费、保荐费（不含税）4,056.60 万元后的募集资金为 491,943.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）637.29 万元后，公司本次募集资金净额为 491,306.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕603 号）。

（二）募集资金使用计划及调整

1. 募集资金投资项目投资金额及募集资金使用计划

本公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	投资金额		核准部门及文号
	总投资额	募集资金投资净额	
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00	钱塘区杭州钱塘新区行政审批局 2204-330114-89-02-524827
SiC 功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00	厦门市海沧区工业和信息化局 2207-350205-06-02-858369
汽车半导体封装项目（一期）	300,000.00	110,000.00	金堂县发展和改革局川投资备（2210-510121-04-01-381195）FGQB-0490 号

补充流动资金	165,000.00	165,000.00	
合 计	1,005,000.00	650,000.00	

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，本公司按照项目的轻重缓急，将募集资金用于年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目、SiC 功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目（一期），不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。其中，年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目实施主体为本公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称士兰集昕公司）、SiC 功率器件生产线建设项目实施主体为本公司控股子公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称厦门明镓公司）、汽车半导体封装项目（一期）项目实施主体为本公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司（以下简称成都士兰公司），实施方式为募集资金到位后，本公司将利用募集资金对士兰集昕公司、厦门明镓公司、成都士兰公司进行增资。

2. 募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

根据公司 2023 年 11 月 29 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额，具体调整情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	总投资额	原拟用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00	160,000.00
SiC 功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00	75,000.00
汽车半导体封装项目（一期）	300,000.00	110,000.00	110,000.00
补充流动资金	165,000.00	165,000.00	146,306.11
合 计	1,005,000.00	650,000.00	491,306.11

（三）募集资金基本情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023 年 11 月 14 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项 目	金 额
一、募集资金总额	496,000.00
其中：超募资金金额	

减：直接支付发行费用	4,693.89
二、募集资金净额	491,306.11
减：	
以前年度已使用金额	300,363.60
本年度使用金额	11,168.05
暂时补流金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
加：	
募集资金利息收入	3,182.70
三、报告期期末募集资金余额	182,957.16

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2023年12月11日，公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行在杭州签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年1月3日，公司及厦门明镓公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行国家开发银行厦门市分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年1月19日，公司及成都士兰公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行国家开发银行四川省分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司、厦门明镓公司、成都士兰公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金投资项目“SiC功率器件生产线建设项目”已于2025年6月达到预定可使用状态，公司已于2025年6月30日将该项目予以结项，并将项目结余募集资金15.58元转入一般账户用于永久补充流动资金。厦门明镓公司已于2025年7月将该项目结余募集资金15.58元转出至一般账户，并将该募集资金专项账户销户。

（二）募集资金存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司及子公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2023 年 11 月 14 日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
本公司	中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行	19033101040036623	173,040.27	使用中
成都士兰公司	国家开发银行四川省分行	511001000000000000625	9,916.89	使用中
合 计			182,957.16	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2023 年 11 月 14 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
99,915.10	2025 年 2 月 14 日	不超过 12 个月	2025 年 2 月 14 日	2026 年 2 月 10 日	99,915.10

截至报告期末，本公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

附件 1：募集资金使用情况对照表（2026 年 1-6 月）

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

发行名称					2023 年向特定对象发行股票								
募集资金到账日期					2023 年 11 月 14 日								
募集资金总额					491,306.11								
本年度投入募集资金总额					11,168.05								
已累计投入募集资金总额					311,531.65								
变更用途的募集资金总额					不适用								
变更用途的募集资金总额比例					不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	生产建设	否	300,000.00	160,000.00	160,000.00			-160,000.00		2026 年 12 月	不适用		否
SiC 功率器件生产线建设项目	生产建设	否	75,000.00	75,000.00	75,000.00		75,090.34	90.34	100.12	2025 年 6 月	2026 年 1-6 月该项目实现销售收入 15,978.79 万元，实现销售毛利 -5,608.38 万元，实现利润总额-8,439.30 万元	否	否

汽车半导体封装项目（一期）	生产建设	否	110,000.00	110,000.00	110,000.00	11,168.05	90,135.20	-19,864.80	81.94	2026 年 12 月	不适用	否
补充流动资金	补流	否	165,000.00	146,306.11	146,306.11		146,306.11		100.00		不适用	
合 计	—	—	650,000.00	491,306.11	491,306.11	11,168.05	311,531.65	-179,774.46	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						根据公司于 2024 年 11 月 25 日第八届董事会第三十次会议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目”和“汽车半导体封装项目（一期）”是公司完善高端功率半导体领域的重要战略布局，项目建设整体规模较大、资金需求较高。在项目实施过程中，受项目资金到位时间、行业发展和市场竞争情况、IDM 企业各环节产线配套建设情况等因素的影响，公司部分产线建设进度有所放缓。综合考虑当前市场环境，募投项目的实施进度、实际建设情况、项目建设周期以及公司业务发展需求（包括应对外部环境变化进行产品技术升级和产能结构调整）等因素，同时为更好控制投资风险，基于审慎性原则，将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本专项报告三（三）之说明						
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况						无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						无						